

免洗型完全無鹵無鉛錫膏

型號：PF714-P214

Rev.2019/03/07 Ver.01-00

—規格—

項目	規格	規範標準
外觀	呈灰色糊狀，不含異物，不可有結塊	
合金成份	錫/鈹35.0/銀1.0	JIS-Z-3282
熔點	138~187°C	
錫粉粒徑	(Type 4) 20μm ~ 38μm	J-STD-005
錫粉外觀	球型粉	
助焊劑含量	10.5±1.0 wt. %	JIS-Z-3197
黏度	170 ± 50 Pa·s (25±1°C, 10rpm, Malcom)	JIS-Z-3284
活性	ROL0	J-STD-004

—測試內容—

測試項目	測試結果	測試方法
銅板腐蝕試驗	Pass	IPC-TM-650, 2.6.15
鹵素含量試驗	ROL0	BS EN14582
銅鏡試驗	Pass	IPC-TM-650, 2.3.32
黏度試驗(25°C, 10rpm)	170 ± 50 Pa·s	JIS-Z-3284
擴散性試驗	>70%	JIS-Z-3197

—信賴性測試—

測試項目	測試結果	測試方法
表面絕緣阻抗試驗 ▲	Pass	IPC-TM-650, 2.6.3.7
電子遷移試驗 ◆	Pass	IPC-TM-650, 2.6.14.1

▲ 試驗環境：40°C, 90% RH 168 hrs

◆ 試驗環境：65°C, 88.5% RH 596 hrs

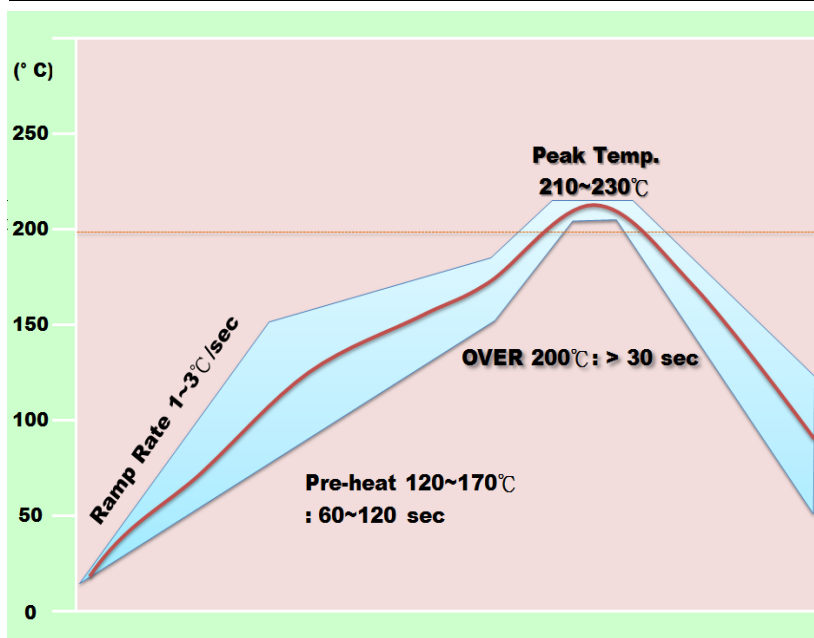
—合金組成—

錫 Sn	鉍 Bi	銀 Ag	銅 Cu	鎳 Ni	鉛 Pb	銻 Sb	鎘 Cd	金 Au	銦 In	鋁 Al	砷 As	鐵 Fe	鋅 Zn
REM.	34.0~ 36.0	0.8~ 1.2	0.05 Max	0.01 Max	0.05 Max	0.05 Max	0.002 Max	0.05 Max	0.10 Max	0.001 Max	0.03 Max	0.02 Max	0.001 Max

本產品成份均完全符合歐盟 RoHS 與 SONY 綠色夥伴中特定有害物質管制之要求。

(wt.%)

—建議溫度曲線圖—



條件	參數
Ramp Up Rate (30~120°C)	1.0~3.0°C/sec
Pre-heating Time (120~170°C)	60~120 sec
Time Period Above 200°C	>30 sec
Peak Temperature	210~230°C
Ramp Down Rate During Cooling	1.0~6.0°C/sec

此為PF714-P214建議的迴焊曲線。由於迴焊爐，組裝配置，或其他過程變異之因素，故最優化的迴焊曲線可能會有所不同。

—保存與使用方法—

1、保存方法

- (1) 錫膏的存放要控制在0~10°C的環境下，錫膏使用期限為6個月(未開封)。
- (2) 不可放置於陽光照射處。

2、使用方法 (開封前)

- (1) 開封前須將錫膏溫度回升到使用環境溫度上(22~28°C)，回溫時間約為3~4小時，並禁止使用其他加熱器使其溫度瞬間上升的做法。
- (2) 回溫後須充分攪拌，使用攪拌機的攪拌時間約為1~3分鐘，視攪拌機機種而定。

3、使用方法 (開封後)

- (1) 將錫膏約2/3的量添加於鋼板上，盡量保持以不超過1罐的錫膏量於鋼板上。
- (2) 視生產速度，以少量多次的添加方式補足鋼板上的錫膏量、以維持錫膏的品質。
- (3) 當天未使用完的錫膏，不可與尚未使用的錫膏共同置放。建議錫膏開封後於24小時內使用完畢。
- (4) 錫膏印刷在基板後，建議於6小時內置放零件並進入迴錫爐完成著裝。
- (5) 換線超過一小時以上，請於換線前將錫膏從鋼板上刮起收入錫膏罐內封蓋。
- (6) 為達到最好的作業環境，室內溫度請控制於22~28°C，濕度RH30~60%。
- (7) 欲擦拭印刷錯誤的基板，建議使用乙醇、IPA清潔。

—本公司聯絡資料—

昇貿科技股份有限公司

地址：桃園市觀音區觀音工業區工業二路12-1號

電話：(886)3-416-0177

傳真：(886)3-416-0133

電子信箱：sales@shenmao.com

分公司

請參考本公司網站

網址：<http://www.shenmao.com>